公司代码:688020　　公司简称:方邦股份

广州方邦电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于报告期内公司净利润为负,同时研发投入保持较高强度,最近三个会计年度研发投入占营收的比重均超15%,为更好推进产品技术持续创新迭代及市场开拓,综合考虑公司经营计划、研发投入及未来发展资金需求,公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王作凯	赵璇
联系地址	广州市黄埔区东枝路 28 号	广州市黄埔区东枝路 28 号
电话	020-82512696	020-82512696
传真	020-32203005	020-32203005
电子信箱	dm@fbflex.com	dm@fbflex.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案,现有产品主要是电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板、电阻薄膜等。

其中电磁屏蔽膜、电子铜箔、挠性覆铜板和电阻薄膜是公司报告期内的主要收入来源。

2、主要产品及服务情况

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种厚度在微米级别、具有复杂结构的薄膜,具有抑制电子元器件电磁干扰的功能,通过贴合于 FPC 产生作用。现代电子产品“轻薄短小”和高频高速化趋势更加明显,驱动着电子元器件及其组件内外部的电磁干扰,以及信号在传输中衰减问题逐渐严重,对电磁屏蔽膜的需求更大,同时也提出了更高的性能要求。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为 HSF6000 和 HSF-USB3 两大系列。其中 HSF-USB3 系列是 2014 年推出的新型电磁屏蔽膜,具备自主研发的独特微针型结构,屏蔽效能进一步提高,同时可大幅降低信号传输损耗,降低传输信号的不完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。

(2)铜箔产品

报告期内,公司铜箔产品主要包括带载体可剥离超薄铜箔(以下简称“可剥铜”)、各类电子铜箔。

带载体可剥离超薄铜箔是制备芯片封装基板、HDI 板的必需基材。目前 IC 载板、类载板的线宽线距已细至 10/10μm-40/40μm,用传统的减成法制程工艺无法制备,主要使用 mSAP(半加成工艺),而 mSAP 必须使用可剥铜。公司生产的可剥铜具有厚度极薄、表面轮廓极低、载体层和可剥离层之间的剥离力稳定可控等特性,可满足 mSAP 的制程要求。

电子铜箔是制造覆铜板(CCL)、挠性覆铜板(FCCL)、印制电路板(PCB)、柔性电路板(FPC)的主要原材料,主要有高温高延伸铜箔(HTE)、低轮廓铜箔(LP),主要应用于多种类常规覆铜板及线路板;反转处理铜箔(RTF),主要应用于高频高速板;超低轮廓铜箔(VLP)和高频超低轮廓铜箔(HVLP),主要应用于高频高速、低损耗要求的电路板等。报告期内公司量产的电子铜箔主要为 HTE、LP 和 RTF,其厚度、延伸性、面密度、耐热性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。

(3)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)是 FPC 的加工基材,由挠性绝缘层与金属箔构成。根据产品结构,挠性覆铜板可分为有胶三层挠性覆铜板(3L-FCCL)和无胶两层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据产品厚度,每类挠性覆铜板又分为普通型和极薄型。

下游电子产品快速发展,推动 FPC 制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对 FPC 的高密度互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL 是实现高密度互连技术的关键材料之一,可大幅提升电子元器件组装密度并节约组装空间,并实现超细线路 FPC 的制备。公司采用自研自产原材料(主要是 RTF 铜箔和 PI/TPI)的技术路径生产 FCCL,可降低生产成本,同时实现其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标满足下游需求,具有良好的加工性能。

(4)电阻薄膜(埋阻铜箔)

随着 5G 通讯技术应用、芯片制程日益先进以及高速高性能电子产品的骤增,电子电路发展倾向于小型化、易封装、高频高速特点。传统无源器件贴装使 PCB 表面焊盘增多、PCB 可用表面积减少、焊盘元件间的寄生效应增加,造成高频信号传输不稳定。采用埋入式技术实现无源器件如电阻等一体化集成替代常规的表面贴装电阻,成为解决该问题的重要手段。

电阻在无源元器件中占主要组成,电阻埋入电路板内部带来的好处并不仅仅是节约了电路板表面的空间,而且电路板表面焊接点将产生电感量,埋入的方式消除了焊接点,因此也就减少了引入的电感量,从而降低了电源系统的阻抗。同时由于消除了焊接点(电路板上最容易引入故障的部分),可靠性也得到了明显提高。

相比于传统电阻元器件,电阻薄膜成为替代传统表面贴装电阻器件的最佳技术路线,在电阻功率放大、电压转换、信号输入/输出、温度补偿和电源滤波等方面发挥着重要作用。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购、批量订购”的采购模式,由采购人员根据各个品种需求量和生产计划时间以及库存情况,确定每个品种的订购批量并发出订货需求单。公司的采购体系执行 ISO9000 标准,采购价格确定方式主要采用询价模式。

2、生产模式

公司采用“以销定产、需求预测相结合”的生产模式,由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标,生产部门根据订单情况及产品库存情况安排相应的生产计划。

公司电磁屏蔽膜核心生产环节包括载体膜表面处理、绝缘层涂布、金属合金层形成、微针状金属层形成、导电胶层涂布等,铜箔生产核心环节为溶铜、生箔、后处理等,挠性覆铜板生产核心环节包括混胶合成、涂布、真空溅射、压合等。公司的产品为高端电子材料,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,防止技术秘密外泄,逐步形成了高度自主的生产模式,上述生产环节均由公司自主完成,不存在外协加工的业务模式。公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测,并对最终产品进行质量检验。

3、销售模式

报告期内,公司的销售模式为直销模式,直接客户为线路板厂商和覆铜板厂商,最终用户为智能手机、平板电脑以及汽车行业等品牌厂商。

公司一方面根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况,自行针对目标市场进行产品开发,为下游客户提出解决方案;另一方面,公司和下游客户以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系,形成了良性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和销售。

产品开发完成后,由下游客户进行打样、工艺验证和基本性能测试,通过后由封装/终端品牌厂商进行整体性能测试,之后通过小批量试产,验证品质的稳定性后即可进入终端产品的物料清单。待相关方就商务条款达成一致,公司即可量产、销售。

4、研发模式

公司长期坚持自主创新,采用定制式研发和主动式研发相结合的方式。在定制式研发方面,通过与下游终端厂商的技术交流,了解下游终端厂商对电磁屏蔽膜、超薄铜箔、挠性覆铜板等产品的个性化需求,进行定制式研发。在主动式研发方面,采用自主研发的设备,依靠自身积累的经验,根据市场需求,设计产品,生产部门配合研发实验室进行测试确认,不断优化实验方案,不断改进,最终确定方案进行小批量试产,试产成功后再进行大批量生产,逐步提升现有产品的性能。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

①所处行业

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

②行业发展阶段及基本特点

电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如芯片封装、高性能高精密线路板制备密切相关的 5G 通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料,形成“卡脖子”困境。近年来,国家颁布了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。2018 年颁布的《战略性新兴产业分类》,明确将“电磁波屏蔽膜”、“高频微波、高密度封装覆铜板”、“PCB 用高纯铜箔”等电子专用材料列为重点产品。高端电子专用材料自主可控和国产替代的重要性持续提升。

报告期内,公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔,并布局挠性覆铜板、带载体可剥离超薄铜箔、电阻薄膜等高端电子材料,直接下游客户主要为线路板(PCB)厂商、覆铜板厂商,应用终端以消费电子为主,部分应用于汽车电子、人工智能(AI)、先进封装等领域。

从行业发展历程看,PCB 及上游电子专用材料行业早期主要受消费电子需求拉动,智能手机、平板电脑、可穿戴设备等终端产品的普及,推动了 FPC、FCCL、电磁屏蔽膜、电子铜箔等细分领域持续发展。近年来,随着全球电子产业加快向高算力、高速通信、高可靠性方向演进,行业发展重心逐步由传统消费电子领域向人工智能、数据中心、汽车电子、先进封装等新兴应用领域延伸,行业整体处于由传统消费电子需求主导向多元新兴需求共同驱动的结构性升级阶段。PCB 兼具精密电路互联、低损耗信号传输和稳定机械支撑等作用,被广泛应用于消费电子、通信设备、数据中心、汽车电子、航空航天等领域,是电子信息产业的重要基础。根据 Prismark 预测,2025 年全球 PCB 市场将增长约 6.8%,到 2029 年全球 PCB 产值将达到约 946.6 亿美元,2024 年至 2029 年复合增长率约为 5.2%,表明行业整体仍处于持续增长通道。

消费电子仍是 PCB 及上游电子专用材料最重要的应用领域之一,也是公司电磁屏蔽膜、FCCL 等产品当前最主要的终端应用场景。根据 IDC 预测,2025 年全球智能手机出货量将同比增长 1.5% 至 12.5 亿部,显示消费电子需求总体仍处于温和修复阶段。随着智能手机、平板电脑、可穿戴设备等终端持续向轻薄化、高性能化、集成化方向升级,下游客户对电磁屏蔽性能、信号传输性能、材料厚度控制、耐弯折性及可靠性等方面的要求也不断提高,从而带动相关电子专用材料持续迭代升级。

与此同时,人工智能相关应用的快速发展正成为 PCB 行业的重要增量来源。AI 服务器、数据中心、高速交换机、光模块等领域需求持续增长,推动 PCB 产品加快向高多层、高密度互连、高频高速、低损耗和高可靠性方向升级。根据 Prismark 预测,2023 年至 2028 年 AI 服务器相关 HDI 的年均复合增速将达到 16.3%,反映出行业增长重心正逐步由传统消费电子转向 AI 算力基础设施等高端应用领域。另一方面,在国际贸易摩擦、地缘冲突及产业链安全因素影响下,高端电子专用材料自主可控的重要性进一步凸显,国产替代进程有望持续推进。整体来看,公司所处电子专用材料行业仍处于重要发展机遇期,消费电子需求仍为行业提供重要支撑,人工智能、先进封装、汽车电子等新兴领域则正成为推动行业升级和结构优化的重要力量。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

①公司在行业内拥有较强技术水平,部分产品对标国外,满足供应链本土化

在电磁屏蔽膜领域,公司具有重要的市场、行业地位,市场占有率较高。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。

在挠性覆铜板领域,其主要原材料是铜箔、聚酰亚胺(PI)和热塑性聚酰亚胺(TPI),公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板,以逐步打破对国外上游供应链的依赖,建立核心竞争优势和技术壁垒,大幅降低生产成本,提升产品市场竞争力和经济效益。另一方面,制备极薄挠性覆铜板等高端产品,对铜箔厚度、粗糙度以及产品整体剥离力等要求很高,公司现有的技术、工艺和配方可满足以上技术需求。对于极薄挠性覆铜板,目前该产品全球量产供应商主要为日本的东丽和住友。公司自主研发生产的极薄挠性覆铜板,其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标国际先进,具有优异的加工性能。

在超薄铜箔领域,公司生产的带载体可剥离超薄铜箔,目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井金属。公司自主研发生产的超薄铜箔,其铜层厚度及表面粗糙度、剥离强度、抗拉强度等关键指标达到世界先进水平。

②公司产品得到行业内众多知名客户认可并建立了稳定的合作关系

凭借良好的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应,公司积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex、群策、深南、生益科技、兴森、台光等众多优质直接客户,并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星以及相关头部芯片厂商等知名终端客户保持密切的技术交流与合作。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜将受益于 5G-5.5G-6G 通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展。5G-5.5G-6G 环境下,以智能手机、AR/VR 硬件设备为代表的消费电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,其内部结构 FPC 使用量不断增加以提升内部组装密度,同时电子元器件之间的电磁干扰亦愈加严重,这客观上加大了对电磁屏蔽膜的需求,这种需求一方面体现为电磁屏蔽膜使用量的增加,另一方面体现为电磁屏蔽膜性能提升的要求(如厚度更薄、屏蔽效能更高、插入损耗更低、耐弯折性更强、抗撕裂性更强等)。

折叠手机、AI 手机也对电磁屏蔽膜提出了新的需求。折叠手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折。AI 手机方面,据市场分析机构 Canalys 最新预测数据显示,2024 年全球 AI 手机出货量占智能手机总出货量的 16%,到 2028 年这一比例将激增至 54%,年复合增长率(CAGR)为 63%,AI 手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题,要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能。

在国家“碳达峰、碳中和”目标提出之后,我国新能源汽车推广普及进程加快,新能源汽车智能化趋势明显。随着汽车向电动化、智能化发展,FPC 在弯折性、减重、自动化程度高等方面的优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖显示模组、车灯、BMS/VCU/MCU 控制系统、传感器、自动驾驶辅助系统等相关场景,市场预计单车 FPC 用量将超过 100 片。在上述 FPC 应用场景中,又因显示模组有其高清化需求,以及传感器系统需要接收 5G 信号、毫米波等高频高速信号以实现短延迟甚至零延迟的探测反馈和自动驾驶,这些高频高速电路存在对电磁屏蔽的潜在需求。

②挠性覆铜板

作为 FPC 的加工基材,挠性覆铜板将受益于 FPC 市场需求扩大及其细线化趋势。据市场分析机构 Prismark 数据及预测,近 10 年内,全球 FPC 产值规模不断扩张,复合增长率约 3.3%,预计 2028 年全球 FPC 产值有望达到 151.17 亿美元;另一方面,各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,倒逼 FPC 线宽线距越来越精细,这加大了对高性能挠性覆铜板(如无胶二层 FCCL、极薄 FCCL)的需求,因为此类挠性覆铜板的铜箔厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安定性更高,更能满足细线路 FPC 的加工制程。

另外特别值得注意的是新能源汽车对 FPC 的需求不断增大,对上游基材挠性覆铜板形成较强利好。一方面,动力电池 FPC 替代铜线线束趋势明确。相较铜线线束,FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点,在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势,此外 FPC 厚度薄,电池包结构定制,装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上,自动化程度高,适合规模化大批量生产,FPC 替代铜线线束趋势明确,目前国内动力电池主流厂商已经在 Pack 环节批量化应用 FPC。另一方面,FPC 厂商进一步向下游 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)产品布局,通过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。

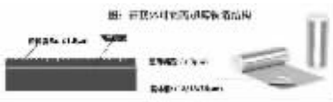
③铜箔产品

公司铜箔产品包括带载体可剥离超薄铜箔、电子铜箔等。

带载体可剥离超薄铜箔是芯片封装基板(IC 载板、类载板)、HDI 板的基材,将受益于芯片制程先进化进程。

目前,半导体芯片技术快速发展、制程日益先进,客观上带动芯片封装领域的 IC 载板、类载板的细线化成为必然趋势,目前 IC 载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm,由于其线宽线距极细,用传统的减层法制程工艺无法制备,主要使用 mSAP。mSAP 是制备芯片封装基板、类载板的主流技术路线,目前,鹏鼎控股、深南电路、安捷利-美维电子、三星电机等国内外大型电路板厂商均主要采用 mSAP 制备 IC 载板、类载板等。

一般铜箔无法满足 mSAP 制程要求,必须用到带载体可剥离超薄铜箔。用于 mSAP 工艺的铜箔,必须满足以下关键条件:A.厚度≤3μm,若无法达到该标准,mSAP 将无法稳定“闪蚀”过厚的铜层,届时将依旧存在减成法特有的“侧蚀”现象,无法制作精细线路;B.表面轮廓 Rz≤1.5μm,若无法达到该标准,过高的铜层表面粗糙度闪蚀不掉,无法制作精细线路,同时也会严重影响 IC 载板、类载板的高频高速特性;C.必须带有载体层和可剥离层,由于薄铜太薄,无法直接应用于实际加工,必须依赖载体层加以辅助稳定;同时,实际加工过程中,只有薄铜最终应用到精细线路制作,载体层必须撕掉,因此必须在薄铜与载体层之间设置可剥离层,同时,必须形成剥离力稳定可控的可剥离层,剥离力过高或过低,都将导致实际加工失败,因此剥离力是制备带载体可剥离超薄铜箔的重大技术难点。



当前,国内外高端芯片龙头企业对带载体可剥离超薄铜箔存在较大需求,以实现先进制程芯片与基板的精密互连。然而,带载体可剥离超薄铜箔全球市场被日本三井铜箔垄断,卡脖子问题严重,对与我国高端芯片封装领域密切相关的 5G 通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等关键行业造成较大制约,实现带载体可剥离超薄铜箔的供应链本土化需求较为迫切。

电子铜箔领域。电子铜箔是覆铜板、印制电路板的主要原材料,随着 5G 通信、计算机、汽车电子、物联网、人工智能等行业不断发展与进步,预计电子电路铜箔市场仍将保持增长态势。当前,随着人工智能(AI)服务器需求持续增长,高端高密度互连板(HDI)、高多层板、类载板等成为电子电路板领域的重要增长方向,其对高端电子铜箔的需求随之提升。根据 GGII 统计及预测,到 2030 年全球电子电路铜箔出货量将达到 82.3 万吨,中国电子电路铜箔出货量将达到 53.8 万吨,2021 年至 2030 年复合增长率分别为 3.1% 和 4.8%。其中,对高频、高速、低损耗的高性能铜箔需求将持续增长,而高频高速铜箔目前我国仍主要依赖进口,国产替代空间广阔。

④电阻薄膜(埋阻铜箔)

电阻薄膜将电阻埋入线路板内部线路,除已应用于消费电子产品声学模块外,还可应用于低轨卫星等航空航天场景,一方面可减轻航天器重量,降低发射成本;另一方面取消了传统焊点,可较大幅度提升信号完整性和模块功能稳定性,从而提升航天器在太空环境的品质可靠性。

在常规电阻薄膜的基础上,公司还开发了热敏型薄膜电阻,其可随温度的变化而呈现阻值变化,适用于电子产品内部的芯片主动热管理。随着新能源汽车、AI 技术的高速发展,芯片制程愈加先进、运算速度愈加高速化,由此带来了愈加广泛而严重的芯片发热、散热问题。热敏型薄膜电阻植入于芯片组件与主板连接部分,可及时、精确地感知温度细微变化,进而通过软硬件的设计来实现芯片的主动热管理。热管理是新一代电子产品必须解决的普遍而迫切问题,目前该产品正处于相关客户的测试流程中。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,750,196,681.47	1,800,120,282.08	-2.77	1,945,328,988.11
归属于上市公司股东的净资产	1,330,014,207.91	1,374,196,062.02	-3.22	1,484,916,098.58
营业收入	357,636,948.88	344,570,817.57	3.79	345,149,314.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	333,480,628.50	306,986,897.88	8.63	329,331,001.93
利润总额	-75,389,662.56	-89,749,018.36	不适用	-68,268,860.12
归属于上市公司股东的净利润	-83,622,365.83	-91,642,742.25	不适用	-68,670,118.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,470,818.06	-112,768,813.12	不适用	-85,851,515.65
经营活动产生的现金流量净额	1,621,296.96	-45,967,720.46	不适用	-12,803,081.70
加权平均净资产收益率(%)	-6.24	-6.43	增加 0.19 个百分点	-4.54
基本每股收益(元/股)	-1.26	-1.14	-10.53	-0.86
稀释每股收益(元/股)	-1.24	-1.13	-9.73	-0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	17.38	17.97	减少 0.59 个百分点	16.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	88,730,690.51	83,611,181.56	95,964,238.07	89,330,838.74
归属于上市公司股东的净利润	1,435,622.28	-25,293,489.49	-2,825,421.55	-56,939,077.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,095,667.50	-28,689,476.66	-12,958,028.38	-48,727,645.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,028,819.46	31,453,682.83	20,479,460.87	-24,283,027.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,312
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,015
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡云连	0	14,555,802	17.67	0	无	0	境内自然人
广州力加电子有限公司	0	14,086,260	17.1	0	无	0	境内非国有法人
海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)	0	7,200,000	8.74	0	无	0	境内非国有法人
易红琼	0	4,979,672	6.05	0	无	0	境内自然人
李冬梅	60,000	2,428,089	2.95	0	无	0	境内自然人
申小玲	908,122	908,122	1.1	0	无	0	境内自然人
袁金楠	20,000	810,000	0.98	0	无	0	境内自然人
姜雨	803,110	803,110	0.97	0	无	0	境内自然人
姜仕鹏	686,831	686,831	0.83	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	510,444	524,694	0.64	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东;苏静、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏静与李冬梅为夫妻关系,共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙),除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

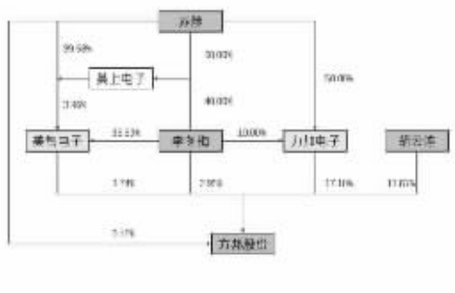
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

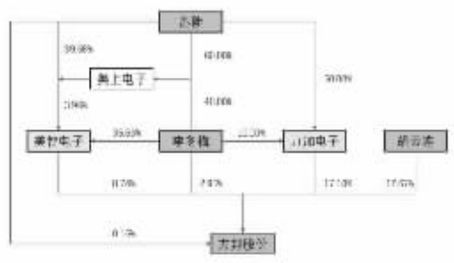
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 35,763.69 万元,较上年增长 3.79%;归属于母公司所有者的净利润为 -8,362.24 万元,较上年同期亏损收窄 802.04 万元,主要系:(1)屏蔽膜业务:受全球智能手机需求放缓、产业链竞争加剧及终端客户持续推进降本影响,屏蔽膜销售收入同比下降 5.75%,毛利较上年减少 274.63 万元;与此同时,高端屏蔽膜销量同比增加 19.77 万平方米,产品结构持续优化,在一定程度上对冲了普通产品销量下滑带来的不利影响。(2)新产品业务:公司新产品逐步放量,其中电阻薄膜(埋阻铜箔)销售额大幅增长,对公司营业收入和利润形成一定贡献;FCCL 产品销售额同比增长 71.21%,随着销售规模提升带动固定成本逐步摊薄,FCCL 业务亏损较上年同期有所收窄,经营改善趋势逐步显现。(3)铜箔业务:公司持续推进铜箔业务产品结构优化,业务毛利亏损有所减少。其中,可剥铜已通过相关代表性载板厂商和头部芯片终端的量产认证,持续获得小批量订单,销售额于本年度保持增长,国产替代趋势进一步显现;此外,毛利相对较高的 RTF 铜箔实现较快增长,销售额同比增长 339.45%,对铜箔业务结构改善和盈利能力修复形成积极支撑。(4)其他收益影响:报告期内,可剥铜专项受托开发项目已通过客户结项验收,确认相应收入,增加利润 929.25 万元,对本期业绩形成正向贡献。(5)减值及公允价值变动影响:受铜箔业务持续亏损影响,公司基于审慎性原则,对铜箔相关固定资产组计提减值准备 2,498.72 万元,较上年同期增加减值 950.07 万元;同时,公司对江苏上达半导体有限公司的投资,其 COF 业务具备一定发展前景,但因标的公司实际控制人违规对外担保导致其承担较大债务,公司出于财务审慎原则计提该笔投资公允价值变动损失 1,500 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2026-018

广州方邦电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事宜概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

为满足公司未来发展需要,公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时,董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、本次授权事宜具体内容

本次提请股东会授权董事会办理的事宜包括但不限于以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

(三)发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过 35 名(含 35 名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价基准日、发行价格和定价原则

发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在股东会授权后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

(六)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金使用不得进行财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

4、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(九)决议的有效期

本项授权自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时,董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使,转授权有效期同上。

(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议,在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件;

2、授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制